PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-298433

(43)Date of publication of application: 10.11.1998

(51)Int.CI.

CO8L 83/04

CO8J 5/18 C08K 3/04

(21)Application number: 09-110988

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

LTD

(22)Date of filing:

28.04.1997

(72)Inventor: FUKUYA NAOHITO

KAJITA SUSUMU

(54) SILICONE RUBBER COMPOSITION AND HEAT -RADIATING SHEET

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a silicon rubber composition which gives a heatradiating sheet having excellent flexibility and a high heat conductivity and to provide a heatradiating sheet having a high heat conductivity.

SOLUTION: This composition comprises a silicone rubber and a filler, said filler being spherical graphite having an interplanar spacing of 3.30-3.40 & angst; or such a composition wherein the spherical graphite used is a combination of small-diameter spherical graphite having a mean particle diameter of 3-9 μ m with a large-diameter spherical graphite having a means particle diameter of above 9 to 50 μ m. The heat-radiating sheet is prepared by molding either of the above compositions.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.05.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-298433

(43) 公開日 平成10年(1998) 11月10日

(51) Int. C1. 6	識別記号	FI
C 0 8 L	83/04	C 0 8 L 83/04
C 0 8 J	5/18 CFH	C 0 8 J 5/18 C F H
C 0 8 K	3/04	C 0 8 K 3/04
	審査請求 未請求 請求項()数4 OL (全7頁)
(21)出願番号	特願平9-110988	(71)出願人 000005832 松下電工株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)4月28日	大阪府門真市大字門真1048番地
(22) Шия Ц	1 1234 (1331) 4) 126 [(72)発明者 福家 直仁
		大阪府門真市大字門真1048番地松下電工校 式会社内
		(72)発明者 梶田 進
		大阪府門真市大字門真1048番地松下電工材 式会社内
		(74)代理人 弁理士 佐藤 成示 (外1名)

(54) 【発明の名称】シリコーンゴム組成物及び放熱用シート

(57) 【要約】

【課題】 柔軟性が優れていて、高熱伝導率である放熱 用シートを得ることのできるシリコンゴム組成物を提供 すること、及びこのシリコンゴム組成物を用いた柔軟性 が優れていて、高熱伝導率である放熱用シートを提供す ること。

【解決手段】 シリコーンゴムに充填材を配合してなるシリコーンゴム組成物において、充填材としてその結晶面間隔が3.30~3.40オングストロームである球状グラファイトを配合していることを特徴とするシリコーンゴム組成物。また、前記シリコーンゴム組成物において、前記の球状グラファイトとして、平均粒径が3~9 μ mの小粒径球状グラファイトと、平均粒径が9 μ m より大きく50 μ m以下である大粒径球状グラファイトとを併用していることを特徴とするシリコーンゴム組成物。放熱用シートは、前記の何れかのシリコーンゴム組成 成物を用いて成形してなる放熱用シート。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコーンゴムに充填材を配合してなるシリコーンゴム組成物において、充填材としてその結晶面間隔が3.30~3.40オングストロームである球状グラファイトを配合していることを特徴とするシリコーンゴム組成物。

1

【請求項2】 前記の球状グラファイトとして、平均粒径が3~9 μ mの小粒径球状グラファイトと、平均粒径が9 μ mより大きく50 μ m以下である大粒径球状グラファイトとを併用していることを特徴とする請求項1記 10載のシリコーンゴム組成物。

【請求項3】 前記の小粒径球状グラファイトと共に使用する大粒径球状グラファイトの平均粒径が $20\sim50$ μ mであって、小粒径球状グラファイトの含有割合が、小粒径球状グラファイトと大粒径球状グラファイトの合計体積に対し $20\sim80$ 体積%であることを特徴とする請求項2記載のシリコーンゴム組成物。

【請求項4】 請求項1から請求項3までの何れかに記載のシリコーンゴム組成物を用いて成形してなる放熱用シート。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、コンピュータのCPU(中央演算処理装置)や各種トランジスタ等の電子部品から発生する熱を放熱するために用いる放熱用シート等の製造に使用されるシリコーンゴム組成物及びこのシリコーンゴム組成物を用いた放熱用シートに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、パソコン、ワークステーション等のクロック数の増加、集積度の増加に伴い、電子部品からの発熱量の増加が深刻な問題となっている。また、パワーICからの発熱についても問題となっている。これら電子部品からの発熱を効率よく放熱するための放熱器を設けることが一般的であり、この放熱器を設けるにあたっては、通常、電子部品と放熱器の間に放熱用シートを配置する。電子部品と放熱器の間に空隙が生じた場合、この空隙が熱伝導の大きな抵抗となるため、電子部品と放熱器の間に放熱用シートを配置して、放熱器の接合面の微少な反りやうねりに沿わせることによって、空隙が生じることを防ぐようにしているのである。

【0003】放熱用シートとしては、柔軟性を持ったゴムシートや、両面に接着剤をコーティングしたテープ等があるが、その熱伝導率を上げるために、アルミナ [熱伝導率 (λ) = 20 W/mK) や六方晶窒化ホウ素 (h-BN) [熱伝導率 (λ) = 62 W/mK] 等の高熱伝導性の無機充填材をマトリックス樹脂に混合分散することが行われている。この場合のマトリックス樹脂の例としては、耐熱性に優れ、広い温度範囲で良好な圧縮復元性を示すシリコンゴムが知られている。

【0004】しかしながら、前記のような無機充填材を 50 トロームである球状グラファイトを配合するが、この作

シリコンゴムに分散する方法で熱伝導率を上げようとした場合、放熱用シートのゴム硬度で表される柔軟性が損なわれる傾向があるため、この方法による高熱伝導率化では不十分である場合があった。なお、放熱用シートに柔軟性が求められるのは以下の理由による。すなわち、電子部品と放熱器の間の空隙の低減を目的として、放熱器を放熱用シートを介して電子部品に取り付ける際には、適度な締め付け圧力をかけることが通常行われるが、放熱用シートのゴム硬度が高いと、電子部品あるいはそれを実装したプリント配線板に大きな荷重がかかり、故障を引き起こす原因となるからである。

【0005】そこで、マトリックス樹脂がシリコンゴムであり、JIS-K6301 A で規定されたゴム硬度測定法によるゴム硬度で代表される柔軟性が優れていて、且つ、高熱伝導率である放熱用シートの開発が望まれている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記のような事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、マトリックス樹脂がシリコンゴムであり、ゴムの度で代表される柔軟性が優れていて、且つ、高熱伝導率である放熱用シートを得ることのできるシリコンゴム組成物を提供すること、及びこのシリコンゴム組成物を用いた柔軟性が優れていて、且つ、高熱伝導率である放熱用シートを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1に係る発明のシリコーンゴム組成物は、シリコーンゴムに充填材を配合してなるシリコーンゴム組成物において、充填材としてその結晶面間隔が3.30~3.40オングストロームである球状グラファイトを配合していることを特徴とする。

【0008】請求項2に係る発明のシリコーンゴム組成物は、請求項1記載のシリコーンゴム組成物において、前記の球状グラファイトとして、平均粒径が $3\sim9~\mu$ mの小粒径球状グラファイトと、平均粒径が $9~\mu$ mより大きく $5~0~\mu$ m以下である大粒径球状グラファイトとを併用していることを特徴とする。

【0009】請求項3に係る発明のシリコーンゴム組成物は、請求項2記載のシリコーンゴム組成物において、40 前記の小粒径球状グラファイトと共に使用する大粒径球状グラファイトの平均粒径が20~50μmであって、小粒径球状グラファイトの含有割合が、小粒径球状グラファイトと大粒径球状グラファイトの合計体積に対し20~80体積%であることを特徴とする。

【0010】請求項4に係る発明の放熱用シートは、請求項1から請求項3までの何れかに記載のシリコーンゴム組成物を用いて成形してなる放熱用シートである。

【0011】本発明のシリコーンゴム組成物では、充填材としてその結晶面間隔が3.30~3.40オングストロームである砂サグラファイトを配合するが、この作

用について説明する。グラファイトはその密度が2.3 g/cm³以下であるので充填材として使用すると、高 熱伝導率化のための充填材として従来使用されているア ルミナ(密度: 3. 98g/cm³) を用いた場合に比 べ密度が小さい放熱シートが得られるので電子機器等の 軽量化に寄与することができる。そして、結晶面間隔が 3. 30~3. 40オングストロームであるグラファイ トは高熱伝導率化に寄与する。さらに、球状グラファイ トであることは、ファイバー等の非球状のものに比べ、 同一充填量であれば、得られる放熱シートのゴム硬度を 10 小さくできる作用がある。これらの作用のため、充填材 としてその結晶面間隔が3.30~3.40オングスト ロームである球状グラファイトを配合すると、密度が小 さくて、ゴム硬度が低く、且つ、高熱伝導率である放熱 用シートを得ることが可能となる。

【0012】さらに、本発明のシリコーンゴム組成物を 配合する際に、平均粒径が3~9μmの小粒径球状グラ ファイトと、平均粒径が 9μ mより大きく 50μ m以下 である大粒径球状グラファイトとを併用すると、ゴム硬 度がより低い放熱用シートを得ることが可能となる。 [0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明 する。

【0014】本発明に係るシリコーンゴム組成物で、シ リコンゴムをマトリックス樹脂としいるのは、シリコー ンゴムは耐熱性に優れ、広い温度範囲で良好な圧縮復元 性を示すので、放熱用シートのマトリックス樹脂として 望ましい素材だからである。シリコーンゴムとしては、 二液型や一液型の液状タイプのシリコーンゲル及びシリ コーンゴム、並びに熱加硫型のシリコーンゴム等の各種 30 のシリコーンゴムを使用することができる。

【0015】そして、本発明に係るシリコーンゴム組成 物はシリコーンゴムと共に結晶面間隔が3.30~3. 40オングストロームである球状グラファイトを含有し ている。球状グラファイトは、例えば石炭ピッチ系炭素 であるメソフェイズ小球体と呼ばれる炭素を1600~ 3000℃で熱処理することによりグラファイト化して 得ることができる。なお、このような方法で得た球状グ ラファイトはメソカーボンマイクロピーズと称されてい

【0016】グラファイトの結晶の基本的構造は、六炭 素環を基本骨格とし、結晶面上にこの基本骨格が連なっ ている網目平面が平行に積み重なった層状構造である。 この層状構造の層間隔は結晶面間隔と呼ばれ、グラファ イト化するときの熱処理温度や出発原料の種類等によっ て異なる値となる。ここで、球状グラファイトの結晶面 間隔について、図1の切り欠き断面図を参照して説明す る。モデル図である図1に示すように、球状グラファイ トは基本骨格が連なっている網目状平面1が平行に積み

間の間隔が結晶面間隔2である。この結晶面間隔の値 は、X線回折法により、d (002) 面の間隔を測定し て得ることができる。

【0017】そして、グラファイトの熱伝導率について は、基本骨格が連なっている網目状平面と平行する方向 の方が、網目状平面に垂直な方向よりも高いことが知ら れている。すなわち、網目状平面と平行する方向の熱伝 導率は1000~1500W/mKにも達するが、網目 状平面に垂直な方向の熱伝導率は、平行する方向の熱伝 導率の1/200~1/400程度であると言われてい る。さらに、グラファイト化するときの熱処理温度が高 いほど結晶面間隔は狭くなり、熱伝導率が高くなる。例 えば、1000℃程度の熱処理では結晶面間隔は3.5 0~3.60オングストロームであり、2000℃の熱 処理では結晶面間隔は3.40~3.50オングストロ ームであり、網目状平面と平行する方向の熱伝導率は1 00W/mKであり、2600~3000℃の熱処理で は結晶面間隔は3.30~3.40オングストロームで あり、網目状平面と平行する方向の熱伝導率は1000 20 ~1500W/mKであるというデータもある。本発明 に係るシリコーンゴム組成物で使用する球状グラファイ トは、上記の結晶面間隔が3.30~3.40オングス トロームと狭い、結晶化度の高いグラファイトであるの で、放熱シートの高熱伝導率化に寄与することができ る。結晶面間隔の下限数値を3.30オングストローム としたのは、これより結晶面間隔の狭い球状グラファイ トは入手が困難であるからである。そして、結晶面間隔 が3. 40オングストロームを超えると、高熱伝導率化 を達成することが不十分となるので、上限を3.40オ ングストロームとしている。

【0018】また、本発明に係るシリコーンゴム組成物 で使用する球状グラファイトは、その形状がほぼ球状で あるので、ファイバー等の他の形状に比べ、同一充填量 であれば、得られる放熱シートのゴム硬度を小さくでき る作用がある。ここで言う球状とは、真球状に限定する ものではなく、ほぼ球状であれば良い。

【0019】さらに、前記したようにグラファイトはそ の密度が低いので、グラファイトを充填材として使用す ると、従来使用されているアルミナを用いた場合に比べ 40 密度が小さい放熱シートを得ることができるというメリ ットがある。

【0020】また、本発明のシリコーンゴム組成物に配 合する球状グラファイトとして、平均粒径が3~9μm の小粒径球状グラファイトと、平均粒径が9μmより大 きく50μm以下である大粒径球状グラファイトとを併 用すると、ゴム硬度がより低い放熱用シートを得ること が可能となるので望ましい。これは、粒径の異なる球状 グラファイトを混合して使用することにより、最密充填 構造に近い充填が達成できるためと考えられる。小粒径 重なった層状構造を有していて、この網目状平面1、1 50 球状グラファイトの平均粒径を $3\sim9$ μ mとする理由

6

は、3μm未満のものは得られる放熱用シートのゴム硬 度が高くなる傾向があるため3μm以上であることが好 ましく、また9μmを小粒径球状グラファイトと大粒径 球状グラファイトの境界値として採用したためである。 そして、大粒径球状グラファイトの平均粒径を50 µm 以下とする理由は、50 μmを超える球状グラファイト の入手が困難であるからである。そして、大粒径球状グ ラファイトの平均粒径が20~50μmであって、小粒 径球状グラファイトの含有割合が、小粒径球状グラファ イトと大粒径球状グラファイトの合計体積に対し20~10 80体積%であると、ゴム硬度が低い放熱用シートを得 ることがより確実になるのでより好ましい。これは、粒 径の異なる小粒径球状グラファイトと大粒径球状グラフ ァイトの粒径の差がこの程度ある方が、最密充填構造に 近い充填がより確実に達成できるためと考えられる。ま た、小粒径球状グラファイトと大粒径球状グラファイト の含有割合については上記の範囲内であることがゴム硬 度が低い放熱用シートを得るには有効であり、このこと は下記の実施例における結果からも確認された。

【0021】本発明の放熱用シートは、請求項1から請求項3までの何れかに記載のシリコーンゴム組成物を用いて成形してなる放熱用シートであるので、柔軟性が優れていて、且つ、高熱伝導率である放熱用シートとなる。放熱用シートに成形する方法については、特に制限はなく、シリコーンゴム組成物をそのまま成形したり、*

*あるいは、一旦ガラス布等の基材にシリコーンゴム組成物を含浸した後、成形するようにしてもよい。

[0022]

【実施例】

(実施例1、実施例2、比較例1~比較例4)シリコーンゴムとして、二液型の液状タイプの付加反応型シリコーンゲル(東芝シリコーン社製、品番TSE-3070)を使用し、このシリコーンゲルに、表1に示す配合量で球状グラファイト、グラファイトファイバー又はアルミナを充填材として配合し、混練してシリコーンゴム組成物を得た。充填材の充填量は表1に示す量(体積%)としたが、この体積%は各原料の比重と仕込み重量とを基に算出した値である。そして、使用した球状グラファイト、グラファイトファイバーのグラファイト化のための熱処理温度、結晶面間隔を表1に示す。

【0023】上記で、得たシリコーンゴム組成物を離型フィルムで挟み込み、プレス成形(圧力50kg/cm²)により2mm厚の成形体とした。この成形体を140℃、1時間の条件で硬化させて放熱シートを得た。得た放熱シートについて、熱伝導率、ゴム硬度及び密度を測定し、得た結果を表1に示す。なお、熱伝導率の測定は定常法平板比較法で行い、ゴム硬度の測定はJIS-K6301Aに基づいて行った。

[0024]

【表1】

表1

	1	接例1 実施例 1b	実施例 2		交例1 比較例 1b	比較例 2	比較例 3	比較例 4
充填材の種 類		ラファイ ト	球状グ ラファイ ト		ファイト	球状グ ラファイ ト	球状グ ラファイ ト	アルミ ナ粉
平均粒子径 又は平均長 さ(μm)		6	6	7	00	6	6	6
グラファイト 化のための 熱処理温度 (℃)	28	100	2600	2800		2000	1000	_
結晶面間隔 (オングスト ローム)	3.37		3.40	3.37		3.43	3.57	_
充填材の 充填量 (体積%)	40	50	50	40	50	50	50	50
熟伝導率 (W∕mK)	1.0	1.6	1.5	1.3	2.9	1.0	0.7	1.0
ゴム硬度	1未満	5	5	8	24	5	5	8
密度 (g/cm ³)	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.4	2.5

【0025】表1の結果から次のことが確認された。

0 オングストロームである球状グラファイトを配合した

(1) 充填材としてその結晶面間隔が3.30~3.4 50 実施例1、2とアルミナを配合した比較例4の比較によ

り、同一充填量であっても実施例1、2の放熱用シート は比較例4のそれより、密度が低く、高熱伝導率であ り、且つゴム硬度が低い。

(2) 結晶面間隔が3.30~3.40オングストロー ムである球状グラファイトを配合した実施例1、2は、 形状が非球状であるグラファイトファイバーを配合した 比較例1に比べ、同一充填量であればゴム硬度が低い。

(3) 結晶面間隔が3.30~3.40オングストロー ムである球状グラファイトを配合した実施例1、2は、 結晶面間隔がそれぞれ3.43、3.57である球状グ 10 ラファイトを配合した比較例2、3に比べ、同一充填量 であれば高熱伝導率である。

【0026】 (実施例3、比較例5) 実施例3は、充填 材の充填量を55体積%とし場合の例であり、球状グラ ファイトとして結晶面間隔が3.37オングストロー ム、平均粒径が6μmのものと、結晶面間隔が3.37* *オングストローム、平均粒径が25μmのものの2種類 を混合使用した際の混合効果を調べた例である。この実 施例3では、使用する球状グラファイトの種類及びその 混合割合を表2に示すようにした他は、実施例1と同様 にしてシリコン樹脂組成物及び放熱シートを作製し、ま た得た放熱シートの性能を測定した。得られた結果を表 2に示すと共に、平均粒径の異なる球状グラファイトを 併用した場合の混合割合とゴム硬度及び熱伝導率の関係 を示すグラフを図2に示した。

【0027】比較例5は、充填材として、平均粒径が2 0μmのアルミナを表2に示す配合量で配合した他は、 実施例3と同様にしてシリコン樹脂組成物及び放熱シー トを作製し、また得た放熱シートの性能を測定した。得 た結果を表2に示す。

[0028]

【表 2 】

表2

	実施例3							
	実施例 3a	実施例 3b	実施例 3c	実施例 3d	実施例 3e	実施例 3f	実施例 3g	比較例5
充填材の種 類	熱処理温度が2800℃の球状グラファイト (小粒径品及び/又は大粒径品)							アルミナ 粉
結晶面間隔 (オングスト ローム)	3.37						-	
球状グラ ファイト中の 平均粒径6 μm品の割 合(体積%)	0	20	25	50	75	80	100	-
球状グラ ファイト中の 平均粒径25 μm品の割 合(体積%)	100	80	75	50	25	20	0	-
充填材の 充填量 (体積%)	55	55	55	55	55	55	55	55
熱伝導率 (W/mK)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.4
ゴム硬度	10	5	4	4	5	5	12	14
密度 (g/cm ³)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.6

【0029】実施例3と比較例5を比較すると、充填材 としてその結晶面間隔が3.37オングストロームであ る球状グラファイトを配合した実施例3は比較例5よ り、ゴム硬度が低く、高熱伝導率であり、且つ密度が低 いことが確認された。

【0030】また、図2でわかるように、球状グラファ イトとして、平均粒径が 6μ mのものと、 25μ mのも のとを混合使用した場合、小粒径球状グラファイトの含

ァイトの合計体積に対し20~80体積%であるとより ゴム硬度が低い放熱シートが得られることが確認され

【0031】(実施例4)実施例4は、充填材の充填量 を55体積%とした場合の例であり、球状グラファイト として結晶面間隔が3.37オングストロームで、平均 粒径が6μmのものと、結晶面間隔が3.37オングス トロームで、平均粒径が35μmのものの2種類を混合 有割合が、小粒径球状グラファイトと大粒径球状グラフ 50 使用した際の混合効果を調べた例である。この実施例4

10

9

では、使用する球状グラファイトの種類及びその混合割 合を表3に示すようにした他は、実施例1と同様にして シリコン樹脂組成物及び放熱シートを作製し、また得た 放熱シートの性能を測定した。得られた結果を表3に示 す。

[0032]

【表3】

表3

	実施例4								
	実施例 4a	実施例 4b	実施例 4c	実施例 4d	実施例 4 o				
充填材の種類	熱処理温度が2800℃の球状グラファイト (小粒径品及び/又は大粒径品)								
結晶面間隔 (オングストロー ム)	3.37								
球状グラファイ ト中の平均粒 径6μm品の割 合(体積%)	0	20	50	80	100				
球状グラファイ ト中の平均粒 径35μm品の 割合(体積%)	100	80	50	20	0				
充填材の 充填量 (体積%)	55	55	55	55	55				
熱伝導率 (W/mK)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9				
ゴム硬度	10	4	3	5	12				
密度 (g∕cm ³)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7				

【0033】表3でわかるように、球状グラファイトと 30 可能となる。 して、平均粒径が 6μ mのものと、 35μ mのものとを 混合使用した際には、小粒径球状グラファイトの含有割 合が、小粒径球状グラファイトと大粒径球状グラファイ トの合計体積に対し20~80体積%であるとよりゴム 硬度が低い放熱シートが得られることが確認された。

[0034]

【発明の効果】本発明のシリコーンゴム組成物は、充填 材としてその結晶面間隔が3.30~3.40オングス トロームである球状グラファイトを配合しているので、 本発明のシリコーンゴム組成物を使用すると、高熱伝導 40 率化のための充填材として従来使用されているアルミナ を用いた場合に比べ、密度が小さく、高熱伝導率であっ て、ゴム硬度の小さい放熱シートを得ることができる。 【0035】請求項2及び請求項3に記載の発明のシリ コーンゴム組成物では、シリコーンゴム組成物に配合す る球状グラファイトとして、平均粒径が3~9μmの小 粒径球状グラファイトと、平均粒径が9μmより大きく 50μm以下である大粒径球状グラファイトとを併用す るので、ゴム硬度がより低い放熱用シートを得ることが

【0036】本発明の放熱用シートは、請求項1から請 求項3までの何れかに記載のシリコーンゴム組成物を用 いて成形してなる放熱用シートであるので、高熱伝導率 化のための充填材として従来使用されているアルミナを 用いた放熱用シートに比べ、密度が小さく、高熱伝導率 であって、ゴム硬度の小さい放熱シートとなる。従っ て、本発明の放熱用シートは、パソコン等の電子機器に とって有用な材料となる。

【図面の簡単な説明】

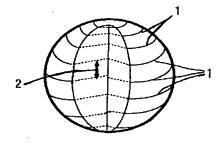
【図1】球状グラファイトの結晶面間隔を説明するため の、モデル的な切り欠き断面図である。

【図2】実施例3における、平均粒径の異なる球状グラ ファイトを併用した場合の小粒径球状グラファイトの混 合割合(体積%)とゴム硬度及び熱伝導率の関係を示す グラフである。

【符号の説明】

- 1 網目状平面
- 2 結晶面間隔

[図1]



【図2】

